

燧原科技：锚定云端AI芯片 致力于成为通用人工智能基础设施领军企业

——上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾	
上海燧原科技股份有限公司董事长、董事会秘书 上海燧原科技股份有限公司总经理	赵立东先生 张亚林先生
中信证券股份有限公司保荐代表人 中信证券股份有限公司保荐代表人 中信证券股份有限公司项目协办人	张 欢先生 陈 泽先生 张锦涛先生

上海燧原科技股份有限公司
董事长、董事会秘书赵立东先生致辞



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家下午好！

非常荣幸能在云端与大家相聚，共同参与上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会。首先，我谨代表燧原科技全体同仁，向莅临本次路演的各位投资者朋友，以及长期以来关注、支持我们的各界伙伴，致以由衷的感谢与诚挚的问候。

燧原科技创立8年来，始终锚定云端AI芯片这一战略赛道，坚持原始创新，至今已成功完成四代架构、五款芯片的迭代，构建了AI芯片、AI加速卡及模组、超节点及智算集群、AI计算及编程软件平台的完整产品体系，已成为我国云端AI芯片领军企业之一。

今天，燧原的多款产品已实现大规模商用，为从AI搜索、广告、推荐，到语

中信证券股份有限公司
保荐代表人张欢先生致辞



尊敬的各位嘉宾、投资者朋友以及各位网友：

大家好！

首先，我谨代表上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及主承销商中信证券股份有限公司，对各位参加本次网上投资者交流会，表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！

燧原科技是国内云端AI芯片赛道上的先行者与中坚力量。自2018年成立以来，公司始终坚持原始创新与自主研发，已构建覆盖AI芯片到智算集群的全

上海燧原科技股份有限公司
总经理张亚林先生致结束语



尊敬的各位投资者、各位嘉宾、各位网友：

大家好！

上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将圆满落幕。在此，我谨代表公司，由衷感谢大家在整个交流过程中给予的热情参与和积极互动。同时，也特别感谢上证路演中心、上海证券报及中国证券网对本次路演活动的大力支持，并向保荐人、主承销商中信证券以及所有中介机构团队的辛勤付出致以诚挚谢意！

沟通是增进理解的桥梁。通过今天坦诚而深入的交流，我们较为系统地展



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

赵立东：公司是我国云端AI芯片领域的领军企业之一，成立8年来，公司自研迭代了四代架构5款云端AI芯片，构建了覆盖AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统及集群和AI计算及编程软件平台的完整产品体系。

问：公司的AI芯片产品主要面向哪些场景，商业化情况如何？

赵立东：公司的AI芯片产品主要用于推理场景，总体采用“训练产品逐步探索，推理产品迅速推进”的产品迭代路径。该策略是基于训练卡作为AI大模型研发的基础设施，追求极致性能与高稳定性，该场景由国际厂商产品主导；推理卡作为AI大模型服务的交付载体，更注重部署成本与场景适配效率，商业化落地更快。

目前，公司多代产品已在广泛的互联网AI场景中实现大规模商用，为从传统AI模型到AI大模型的国家级互联网应用提供算力支撑。同时，公司积极参与国家“东数西算”枢纽节点的智算中心项目，并持续拓展网络运营商及垂类行业的业务机会。

问：公司的强生态合作战略具有哪些成果？

赵立东：在智算中心生态方面，公司已建成多个标杆智算集群，2024年底，在“东数西算”算力枢纽节点甘肃庆阳建成国内首个万卡国产算力推理集群，并与生态伙伴合作逐渐从泛互联网向政务、金融、医疗、教育等领域延伸，形成了国产算力行业的“庆阳模式”；在人工智能应用生态方面，公司与超过100家人工智能产业链上下游企业建立生态合作，适配了DeepSeek、Qwen等近千个AI模型，支持AI+场景应用快速落地；在软件技术生态方面，公司与20余家技术合作伙伴深度协同，持续完善从算子库、编程模型到上层软件栈的技术生态体系，并积极参与开源软件社区共建。经过数年生态建设，公司已与云服务、大模型、垂类模型、解决方案、AIDC建设及运维运营等生态伙伴建立了广泛的合作关系，构建“AIDC+AIGC”双轮驱动的产业生态，推动公司产品实现大规模商业化落地。

问：公司获得过哪些荣誉奖项？

赵立东：截至2025年末，公司参与了58项AI芯片与智算系统的关键国家及行业标准的制定，获得世界人工智能大会“SAII之星”、中国算力大会“年度突破成果”、三次“中国芯”最高奖“年度重大创新突破产品”、“吴文俊人工智能科学技术专项一等奖”、全球“未来产业之星”大赛未来产业超能奖等重要奖项。此外，公司申报的“基于燧原万卡集群的先进计算技术底座实践”成功入选工业和信息化部2025年计算技术底座典型应用案例。公司的甘肃庆阳万卡集群亦为国内首个获中国信通院大规模智算集群服务成熟度五星级认证的国产万卡推理集群。

问：公司取得了多少专利？

张亚林：截至2025年末，公司及其子公司拥有的专利均为境内专利，共339项，其中发明专利313项，实用新型专利22项，外观设计专利4项。

问：公司近年来的收入有多少？

张亚林：2023—2025年，公司营业收入分别为30118.74万元、72238.74万元、99016.00万元，复合增长率达81.32%。2026年1—6月，公司营业收入为112030.76万元。

问：公司主营业务毛利率有多少？

张亚林：2023—2025年，公司主营业务毛利率分别为22.60%、30.59%和31.78%，整体呈持续提升趋势，主要系2024年和2025年公司主营业务以第三代AI加速卡产品为基础，第三代AI加速卡性价比更高、AI模型适配性更广泛，其毛利率高于第二代产品。

问：公司的研发投入情况如何？

张亚林：2023—2025年，公司研发投入分别为122887.58万元、131229.38万元、113499.02万元，占各期营业收入的比例分别为408.01%、181.66%、114.63%。

发展篇

问：公司未来的发展规划是什么？

赵立东：公司是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会成立后第一批入驻企业之一，坚信“科技创新、算力普惠”，致力于成为“通用人工智能基础设施领军企业”。首先，公司未来将继续坚持科技创新，加大研发投入，推动人工智能算力基础设施关键环节的核心技术突破，为中国人工智能产业发展提供高性能的算力保障，赋能千行百业的数字化与智能化转型。其次，公司将继续紧跟国家科技发展战略，积极承担国家重大科技攻关任务，为国家科技创新之路贡献燧原力量。最后，公司将

继续秉持“国芯国造”“开放共建”的经营理念，与国产合作伙伴共同探索打造完全基于国产供应链的云端AI芯片系列产品，推动国产人工智能算力生态链建设，携手软硬件合作伙伴打造具备国际竞争力的国产AI算力综合解决方案，为我国人工智能产业实现高水平自立自强作出贡献。

问：公司产品未来会重点拓展哪些应用领域？

赵立东：未来，公司一方面将继续深化与互联网和大模型厂商的业务合作，另一方面将积极拓展与大型运营商、国企和产业伙伴的合作，打造标杆性算力集群项目，并进一步推动公司自研国产算力产品在智慧城市、智慧金融等垂类场景的应用，逐步实现从互联网场景向更多行业领域延伸，为AI赋能千行百业提供算力支持。

问：公司未来将采取哪些措施以进一步拓展客户群体？

赵立东：公司秉持“优先单点突破、后续以点带线、逐步以线带面”的客户战略，优先在头部互联网客户的海量、高并发、高要求的真实业务场景中快速提升产品和技术能力。

问：公司在研项目有哪些？

张亚林：截至目前，公司第二代高性能云端AI产品研发、第三代高性能云端AI产品研发处于量产阶段，第四代高性能云端AI产品研发处于试产阶段，第五代高性能云端AI产品研发、第六代高性能云端AI产品研发处于研发阶段，AI软件栈自主研发及优化升级、一体化AI智算应用方案研发处于持续迭代阶段。

问：公司在核心技术方面有哪些技术储备？

赵立东：目前，公司主要储备了十万卡以上智算集群技术、256卡以上高密度超节点技术、多芯片板卡和模组技术、计算存储互联分离的芯粒技术、一致性内存多级互联技术、先进计算架构、分布式训练软件技术、加速推理技术、编程模型和编程模板技术以及AI自动设计技术10项技术。

问：公司在产品技术方面有何竞争优势？

赵立东：公司核心AI芯片已历经四次迭代，在处理器架构、计算核心、先进封装、数据搬运及深度学习算子等方面形成了一定的技术优势。在核心技术方面，具备从处理器微架构、指令集、高性能计算核心到芯片封装设计的全栈自主研发能力；在软件生态方面，公司实现了编程模型、运行时库、编译器、算子库等基础软件及算力调度平台的自主研发，支持TensorFlow、PyTorch、Megatron-LM、DeepSpeed等主流框架，以及DeepSeek、Qwen、LLaMA、ResNet、YOLO等主流模型。通过软硬件协同优化，充分发挥人工智能产品性能。

问：公司在大规模AI算力集群建设方面具备哪些优势？

赵立东：公司联合合作伙伴共同打造超节点方案，现已完成整机点亮，系统集成与适配，软硬件系统联合优化进展顺利。在前期间合作伙伴联合研发的基础上，已初步完成整个系统的集成、联调、优化、部署，在核心指标方面已快速实现设计目标，并实现超节点软硬件及基于用户场景的协同优化。基于第四代芯片的超节点产品方案基于RoCE协议实现跨卡和跨节点的卡间通信和计算，在大规模计算集群上可实现Scaleup规模为64卡的高效互联，实现高效协同、互联带宽的弹性聚合，最大程度消除通信瓶颈，可高效支持DeepSeek等MOE模型的专家并行（EP）拆分，支持实时数据分发与并行计算，提升了大规模算力集群的性能，适用于大模型预训练及推理。

公司自2022年推出云端一体化智算集群产品，采用分布式架构，支持千卡级大规模集群高速互联，通过高带宽、全互联拓扑，可实现千卡级大规模集群高速互联，具备优异的线性加速比；通过创新的冷板式液冷技术，大大降低了数据中心PUE；高效支撑大模型的高效并行训练。同时，公司与高校、科研机构及产业合作伙伴在光通信、计算节点、组网方案、集群运维和分布式软件等领域开展合作，持续推进大规模集群方案建设。

问：公司在生态建设上有什么规划？

赵立东：公司与云服务、大模型、垂类模型、解决方案、智算中心建设及运维运营等生态伙伴建立了广泛的合作关系，构建了“AIDC+AIGC”的双轮驱动的产业生态，实现大规模商业化落地。未来，公司将以“芯片+全栈软件工具+超节点系统+智算集群”为基石，秉持“软硬协同、开放共享、场景驱动、合作共赢”的生态理念，推动国产算力产业生态发展与商业化落地。

行业篇

问：公司具体属于哪个行业？

赵立东：根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，公司所属行业分类为“I65软件和信息技术服务业”之“I6520集成电路设计”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1新一代信息技术产业/1.3新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4新型信息技术服务”之“6520集成电路设计”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年），公司所从事的业务属于“1新一代信息技术产业”中“1.3电子核心基础产业”的“1.3.1集成电路”领域；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》，公司所处行业属于第五条“（一）新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”和“人工智能”领域。

问：国内AI加速卡的发展趋势如何？

赵立东：从细分结构来看，中国训练用AI加速卡市场规模在2020年至2024年间以97.95%的复合增速增长，预计2028年将达到2990.64亿元；而推理用AI加速卡则展现出更快的增长趋势，2020年至2024年的年均增速为111.06%，未来四年有望以59.41%的高增速扩张至8085.82亿元，占比逐步提升至超70%。

问：当前环境下行业发展面临哪些机遇？

赵立东：当前，公司所处行业主要面临三方面发展机遇：一是随着各行业积极探索人工智能应用，算力基础设施需求持续增长，DeepSeek等模型的发展也为具备能效比和供应稳定性优势的国产AI芯片带来更多市场机会；二是随着国际贸易的不确定性增强，国内云厂商对本土AI加速卡厂商的合作态度日益开放，国产替代进程有望持续加速；三是国家持续出台人工智能、算力基础设施及集成电路产业相关支持政策，并推进国家算力枢纽节点和数据中心集群建设，为行业发展提供良好环境。

问：公司的市场占有率如何？

赵立东：根据IDC数据和公司销售量情况，2025年，中国AI加速卡整体出货规模约400万张，其中英伟达以约220万张出货量占据约55%的市场份额。公司当年AI加速卡及模组销售量达6.6万张，对应中国AI加速卡市场的占有率约1.7%，在国内其他AI芯片厂商中位居前列。

发行篇

问：公司控股股东和实际控制人是谁？

赵立东：公司暂无控股股东，实际控制人为ZHAOLIDONG和张亚林。

问：公司本次发行所选择的具体上市标准是什么？

赵立东：公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2规定的上市标准中的“（四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

问：截至目前的股权激励情况如何？

赵立东：截至目前，燧原汇智、燧原崇英相关激励人员合计持有公司3953.3337万股股份，占目前公司总股本的10.2070%，涉及激励员工657人。

问：公司本次发行股数是多少？

张欢：公司本次发行股票数量为4303.5173万股，占发行后总股本比例为10.00%，发行后总股本为43035.1728万股。

问：公司本次发行是否有保荐人相关子公司参与战略配售？

张欢：我们将安排相关子公司中信证券投资参与本次发行战略配售，初始跟投比例预计为本次发行数量的5%，即215.1758万股，最终战略配售数量将在确定发行价格后确定。中信证券投资有限公司承诺，获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

问：公司高级管理人员、员工会参与战略配售吗？

陈泽：公司高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量不超过本次发行规模的10.00%，即430.3517万股，同时，不超过33670.00万元，最终战略配售数量将在确定发行价格后确定。燧原科技员工资管计划获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。

问：公司本次募投项目主要有哪些？

张亚林：公司本次拟募集资金60亿元，将投入三个项目：基于五代AI芯片系列产品研发及产业化项目15.03亿元；基于六代AI芯片系列产品研发及产业化项目11.97亿元；先进人工智能软硬件协同创新项目33亿元。